

電力絶縁(低圧)用ベースレジン

	密度	MFR (21.18N)	融点 (DSC法)	1% モ ジュラス*	引張強さ	切断時 伸び	脆化温度 (F50)	デュロ メータ硬 さ	誘電率 (1MHz)	誘電正接 (1MHz)	絶縁 破壊強度	体積固有 抵抗	架橋/ 非架橋	ベース 樹脂	用途	特長
単位	g/cm3	g/10min	°C	MPa	MPa	%	°C	HDD	-	-	kV/mm	ohm.cm	-	-		
銘柄																
NUC-9060	0.923	1.2	109	[210]	17 [15]	600 [500]	< -76	-	2.28	< 0.0001	25	> 10 ¹⁷	非架橋	HP- LDPE	架橋コンパウンドのベースレジン	広範囲の温度において押出加工性が良好で異物が少なく、架橋コンパウンド樹脂に適している。
NUCG-5130	0.923	0.7	123	[280]	32 [21]	900 [570]	< -76	54	2.28	< 0.0001	27	> 10 ¹⁷	非架橋	LLDPE	シラン架橋用ベースレジン	押出加工性と架橋特性のバランスが良好でシラン架橋用のベースレジンに適している。融点が123°Cのため、120°Cでの耐加熱変形性に優れている。
NUCG-7101	0.920	0.7	119	[230]	20 [20]	830 [620]	< -76	52	2.28	< 0.0001	27	> 10 ¹⁷	非架橋	LLDPE	シラン架橋用ベースレジン	押出加工性と架橋特性のバランスが良好でシラン架橋用のベースレジンに適している。グラニュータイプ。
NUCG-9301	0.920	0.7	119	[230]	20 [20]	830 [630]	< -76	52	2.28	< 0.0001	27	> 10 ¹⁷	非架橋	LLDPE	シラン架橋用ベースレジン	押出加工性と架橋特性のバランスが良好でシラン架橋用のベースレジンに適している。

* 2mm厚シート, ダンベル状2号, 試験速度5mm/min

[]はシラン架橋後の値を示します。シランミクスチャー(ビニルシラン)を1.6%添加して押出後にプレス成形して測定。

注) 本カタログの数値は代表的な値を示したものですから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。